

ウェーハ研削の課題解決を提案します

We propose solutions for grinding wafers



ウェーハ研削用

8インチ・6インチ SiCウェーハ 他

For wafer grinding 8-inch and 6-inch SiC wafers, etc.

NEW!

ビトリファイドダイヤモンドホイール

Vitrified Diamond Wheel nanoVi®

nanoVi®

粗加工 Rough

工具寿命を延ばしたい

Would you like to extend tool lifetime?

高強度ガラス結合剤による
ホイール耐摩耗性の向上

Improved wheel wear resistance
by high strength glass binder

8インチ(レーザー切断面)
SiCウェーハにおいて

摩耗率 **12%** 達成

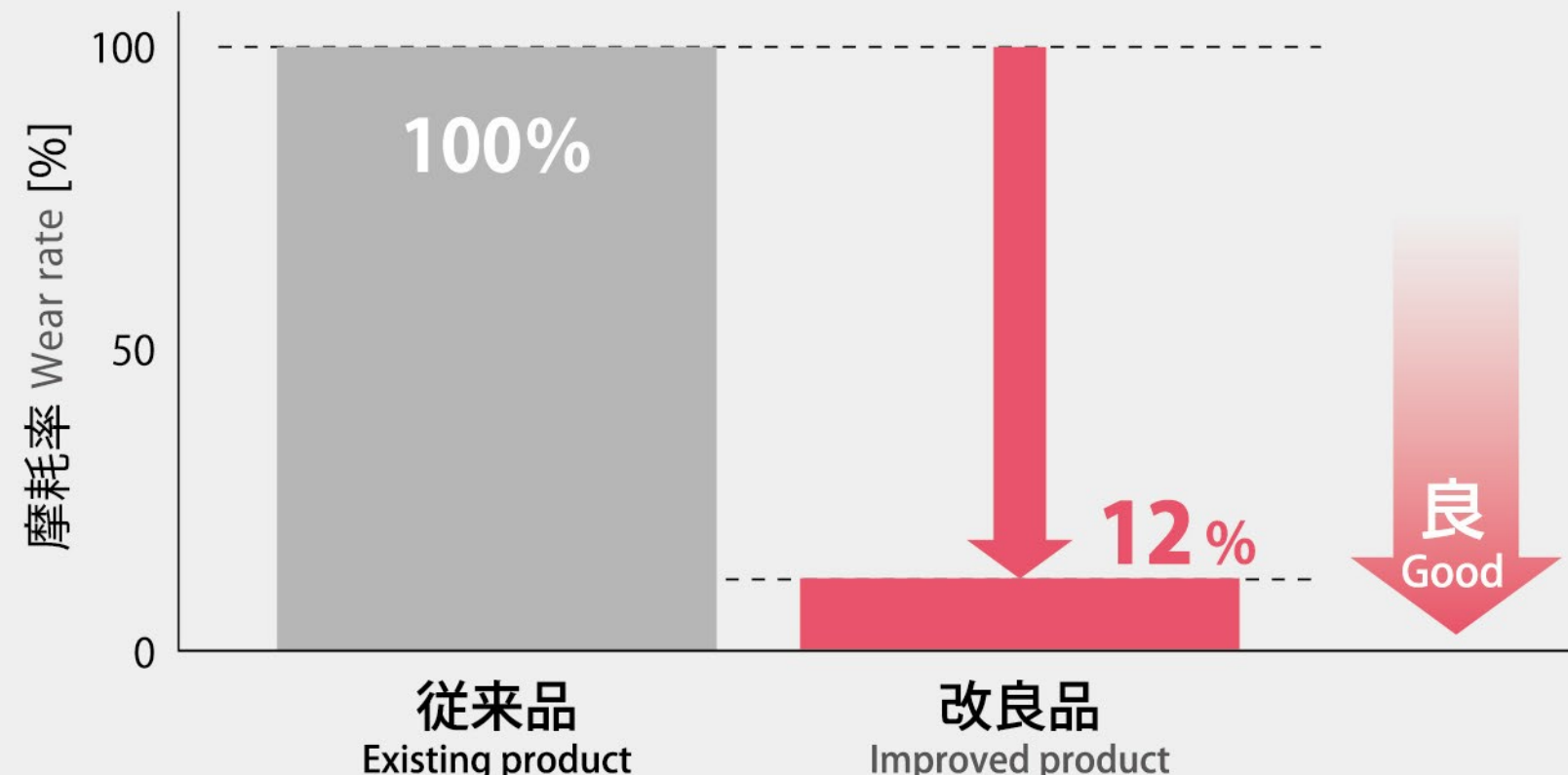
This wheel can achieve 12% wear rate
on 8-inch SiC wafers with laser-sliced surfaces

評価事例
Evaluation example
(SD2000)

送り速度
Feed speed

0.5 $\mu\text{m}/\text{sec}$

摩耗率 Wear rate



仕上げ加工 Finish

加工品質を安定させたい

Would you like to stabilize machining quality?

均一なホイール組織による
砥粒分散性の向上

Improved abrasive grain dispersion
due to uniform wheel structure

8インチ
SiCウェーハにおいて

連続研削でも
安定した表面品位

This wheel can provide stable surface quality
even with continuous grinding on 8-inch SiC wafers

評価事例
Evaluation example
(SD30000)

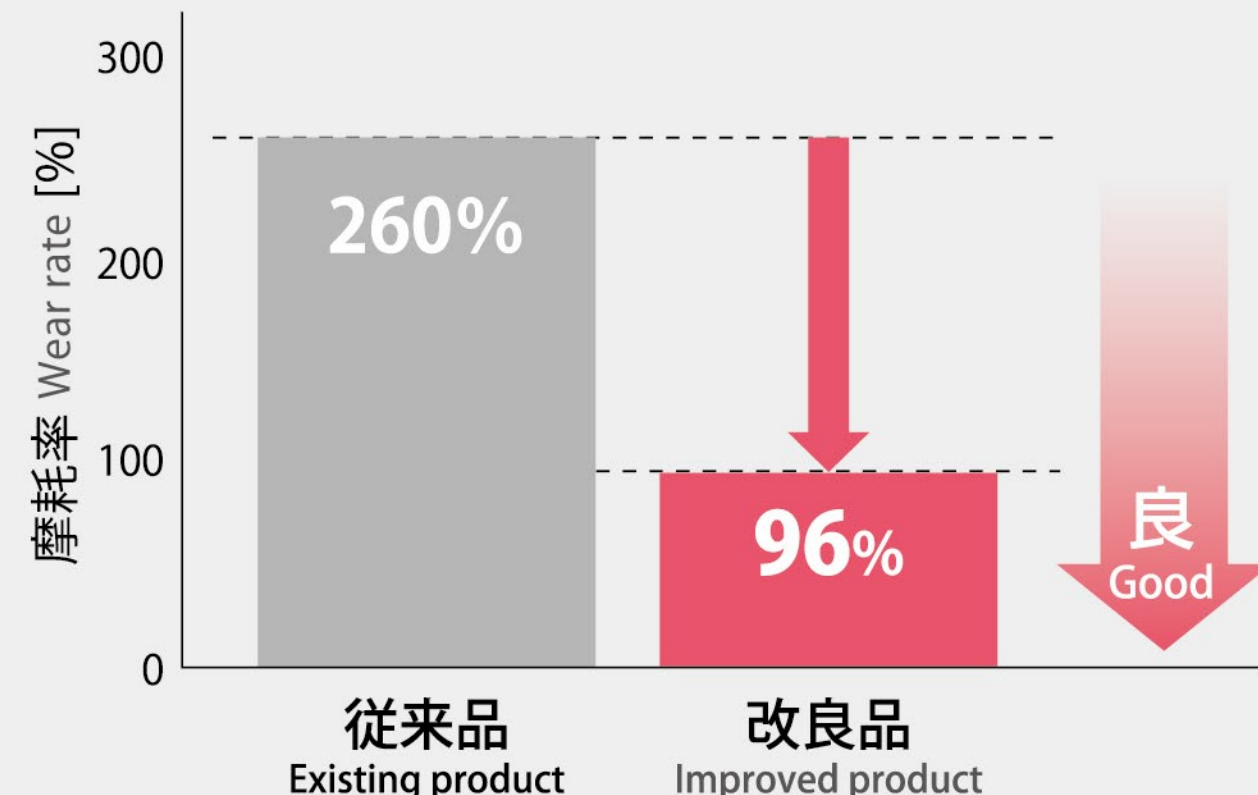
送り速度
Feed speed

0.2 $\mu\text{m}/\text{sec}$

表面あらさ
Surface roughness

Sa 2nm
以下
Sa 2nm or less

摩耗率 Wear rate



当社は「つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション(TPEC)」に参加し協業で本開発を実施しました

Our company participated in the Tsukuba Power-Electronics Constellations (TPEC) and carried out this development in collaboration with the group.

